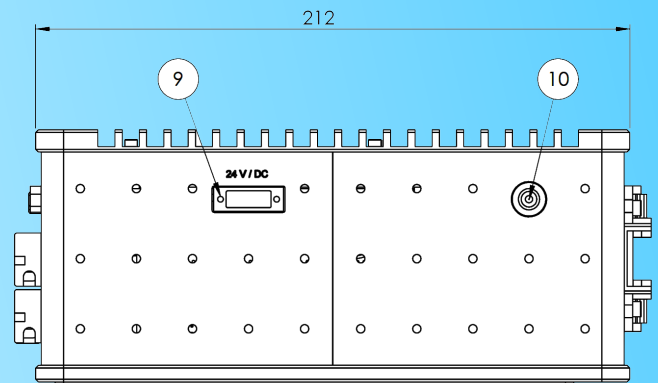
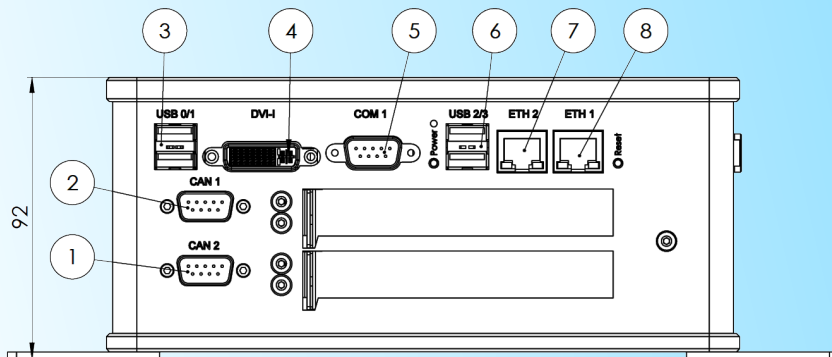
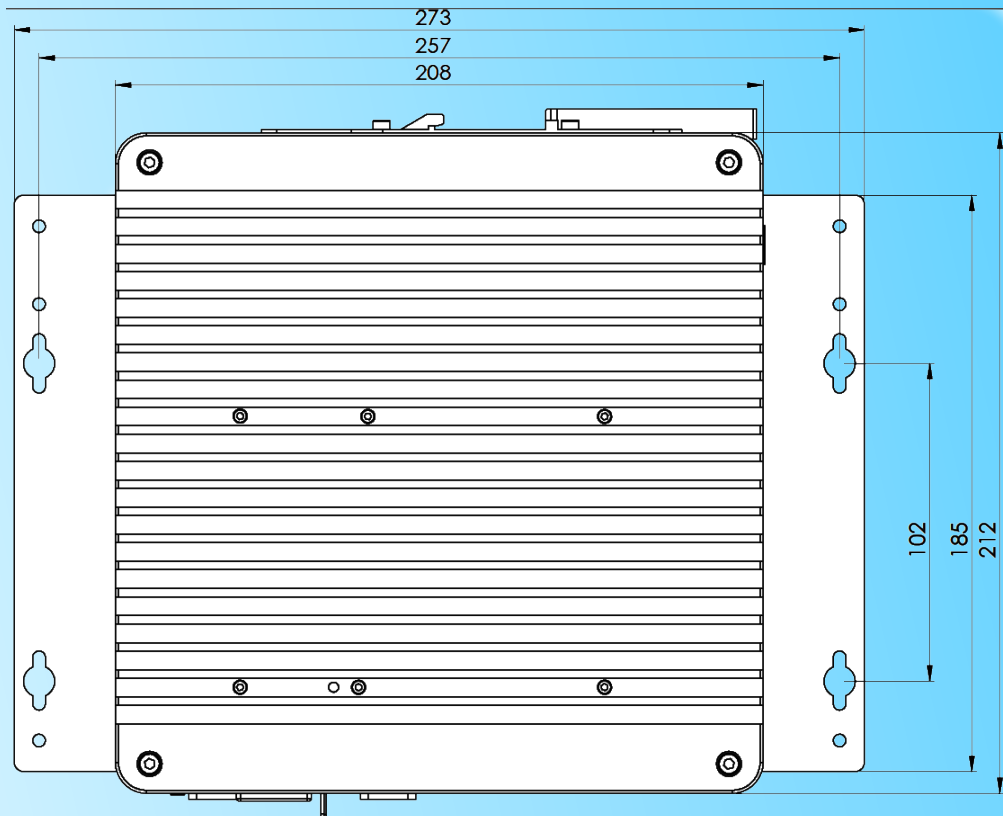


INNOVO VARIO



Vermessung



- 1. CAN / RS232**
- 2. CAN / RS232**
- 3. USB 2.0**
- 4. DV-H Anschluss**
- 5. 1x Sub-D9 (male)**
- 6. USB 2.0**
- 7. Gigabit Ethernet RJ-45 mit Boot-On-LAN / IEEE1588**
- 8. Gigabit Ethernet RJ-45 mit Boot-On-LAN / IEEE1588**

- 9. Spannungsversorgung DC 24 Volt (Filter)**
- 10. Spannungsversorgung 12-36Volt DC**

Mögliche Montage

...durch Hutschienen



...oder Halbleche



Highlights

- **Robustes hochwertiges Gehäuse aus Aluminium "Made in Germany"**
- **Extrem robuste Gesamtkonstruktion durch direkte Montage / Kopplung**
- **Geschlossene Variante sowie mit Lüftungsschlitzen**
- **Passive optimierte Kühlung**
- **EMV geprüft nach Norm: EN55022:2006+A1:2007 Grenzkategorie A (Störaussendung) EN55024:2010 (Störfestigkeit)**
- **Langzeitverfügbarkeit**
- **Hohe Funktionssicherheit und Langlebigkeit (24/7)**
- **Gehäuse optional mit internem Lüfter für kritische Temperaturbereiche**
- **Über Riserkarte flexibel erweiterbar mit PCI/PCIe Karte**
- **Gleichzeitiger Einsatz von 3 verschiedenen Speichermedien möglich (2x2,5" SSD/HDD optional RAID 1), 1 x CompactFlash & 1x CFast Card**
- **Plattform für Industrial Virtualisation mit VMware-vSphere Hypervisor (ESXi)**
- **Sonderkonfigurationen auf Anfrage**

Spezifikationen

RS-IPC-VARIO-1



Gehäuse INNOVO Vario 1 (Einfache Bauhöhe)

Farbe Nach Absprache

Mainboard Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

Wichtig: Vario 1 kein Filter möglich, erst ab Vario 2

RS-IPC-VARIO-2



Gehäuse INNOVO Vario 2 (Zweifache Bauhöhe / 1x Zusatzkarte)

Farbe Nach Absprache

Mainboard Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

RS-IPC-VARIO-3



Gehäuse INNOVO Vario 3 (Dreifache Bauhöhe / 2x Zusatzkarte)

Farbe Nach Absprache

Mainboard Basebaord for COM Express Modules Type 2

- M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format!]
- 24 Volt DC Anschluss (Phoenix)

Spezifikationen

RS-IPC-VARIO-1 / 2 / 3

CFast	1x Steckplatz auf Mainboard Oberseite
CompactFlash	1x Steckplatz auf Mainboard Unterseite
Massenspeicher	1x 2,5“ Harddisk/SSD via SATA (direkt montiert auf Mainboard Unterseite, ohne Kabel)
Filter-Option	für INNOVO Vario 2-3 24 Volt DC Anschluss (Phoenix) EMV geprüft nach Norm 24Volt Filter: <ul style="list-style-type: none">• EN55022:2006+A1:2007 Grenzkategorie A (Störaussendung)• EN55024:2010 (Störfestigkeit)
Schalter-Option	SW-USB-LED Front Option für INNOVO Vario 1-3 <ul style="list-style-type: none">• Einschalter in der Front• HDD und Power Led in der Front• USB2 Anschluss in der Front
Gigabit Ethernet	2x RJ-45 (mit Boot-On-Lan / IEEE1588)
RS232	1x Sub-D9 (male)
RS485	optional über Adapterplatine an COM der internen Display-Schnittstelle
SATA	1x SATA-Anschluss für zusätzliche/s Harddisk oder DVD-Laufwerk
USB	4x USB 2.0 (extern) 2x USB 2.0 (intern auf Pfostenleiste)
I/O-Schnittstellen	1x IO-Extension Interface mit PCIe, USB, LPC, HD-Audio, SVDO, I2C (für proprietäre Erweiterungskarten)
Modul-Steckplatz	COM Express (Basic & Compact, Typ 2)
Mini PCIe	1x Steckplatz auf Mainboard Unterseite (PCIe & USB)
Schnittstelle für Riser	1x Riser-Interface (für Standard PCI/PCIe Karten, max. 2x PCIe & 4x PCI)
Externe Displayschnittstelle	DVI-I Anschluss (digital & analog) für DVI und/oder VGA Monitor
Interne Displayschnittstelle	Dual Channel LVDS (18/24) + USB & COM für Touch
Batterie	1x CR2032 gesockelt
Buzzer	auf dem Mainboard
Lüfteranschluss	1x 3-pol., 12 V, PWM gesteuert, Tacho-Eingang
Reset-Taster	auf Mainboard + Anschluss über Systemsteckverbinder
Spannungsversorgung	ATX 20-Pin; 12V (+/- 5%), 5V (+/- 5%), 3,3V (+/- 5%), 5V Standby
Status-LED	1x Power-LED und 1x Activity LED (auf Mainboard + Anschluss über Systemsteckverbinder)
Stecksystem	1x Pfostenleiste 10-pol. zur Anbindung von Power-Button, Power-LED, Reset-Button und Activity-LED

Varianten

COMKit-D2550-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG **Neuste Intel Atom Technologie**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Atom D2550 / NM10 (conga-CCA/D2550)
(Dual Core, 2x 1.86GHz, 1MB L2 Cache, 10W TDP)
- 2GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung

Auch erhältlich: Varianten mit Intel Atom N2600 / N2800

Hinweis: Bei diesem Kit sind nur die analogen Ausgangssignale des DVI-I Ports verfügbar.
Es können keine digitalen DVI Monitore angeschlossen werden

COMKit-1047E-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG **Effiziente und kostenoptimierte Ultra-Low-Power Dual Core Lösung**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Celeron 1047 (conga-BS77/1047)
(Dual Core, 1.4GHz, 2MB Cache, HD Graphics 3500 HM76)
- 2x 4GB DDR3 SO-DIMM (Max)
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

COMKit-i3-3217UE-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG **Rechenstarke und sparsame Core i3 Dual Core Lösung** **(3. Generation Core Technologie „Ivy Bridge“)**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Core i3-3217UE (conga-BS77/i3-3217UE)
(Dual Core, 1.6GHz, Hyperthreading, 3MB cache,
HD Graphics 4000, 17W TDP), QM77 Chipsatz
- 2x 2GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

COMKit-i7-3517UE-HSP-AA / Hersteller: TQ – Systems GmbH + congatec AG **Höchste Rechenleistung mit sparsamen i7 Dual Core** **(3. Generation Intel Core Technologie „Ivy Bridge“)**

Embedded PC Kit (komplett montiert/geprüft) bestehend aus:

- MB-COME-1 COM Express Carrierboard
- COM Express Modul mit Intel Core i7-3517UE
(Dual Core, 1.7GHz, TurboBoost bis max. 2.8GHz, Hyperthreading,
4MB cache, HD Graphics 4000, 17W TDP) QM77 Chipsatz
- 2x 4GB DDR3 SO-DIMM
- Heatspreader für direkte thermische Anbindung
(mit integrierten Heatpipes für optimale Wärmeverteilung)

Optionen

RS-IPC-IAP-HB Haltebleche Rechts und Links

RS-Set-HDD-KT-SSD64 SANDISK X110 64GB SSD SATA3 6,35cm 2.5Zoll Industrie
+
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

RS-Set-HDD-KT-SSD128 SANDISK X110 128GB SSD SATA3 6,35cm 2.5Zoll Industrie
+
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

RS-Set-HDD-KT-SSD256 SANDISK X110 256GB SD6SB2M-256G SSD X210 6,35cm 2,5Zoll 7mm
+
Mounting Set für eine direkte Montage einer 2,5“ HDD/SSD im unteren Bereich des Mainboards MB-COME-(-T)

RS-RISER-COME- PCI Riser Adapter für eine PCI Standard-Karte am Mainboard

RS-RISER-COME-PCIE Riser Adapter für eine PCIe x1 Standard-Karte am Mainboard

RS-Set-HDD-KT Montageset für direktes Montieren einer 2,5“ HDD/SSD am Mainboard MB-COME-1L(-T)

Entsorgung

Das Gerät kann beim Hersteller kostenlos entsorgt werden:

R&S Informations- und Computersysteme GmbH
Riedstraße 2
D 53859 Niederkassel

e-mail: info@rscomputer.net